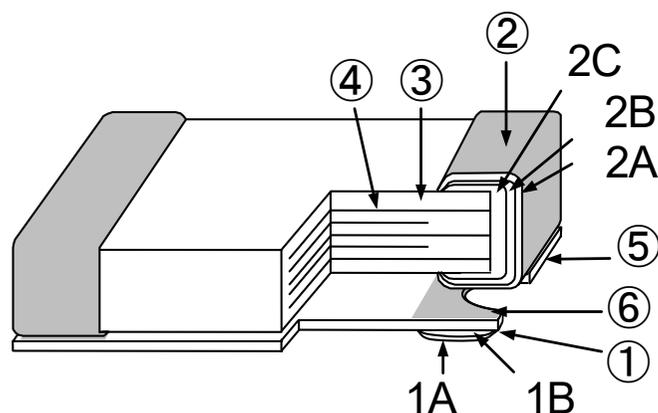


インターポザ基板付きチップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表

Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor on Interposer

<ZRB Series>

1.内部構造/Structure



2.材料名/Material

| No. | 名称 Name | 材料/Material |
|-----|----------------------------------|---|
| ① | 外部電極/Termination | |
| | 1A めっき層/Plated layer | すず/Tin |
| | 1B 下地電極/Electrode | 銅/Copper |
| ② | MLCC 外部電極/MLCC Termination | |
| | 2A MLCC めっき層/MLCC Plated layer | すず/Tin |
| | 2B MLCC めっき層/MLCC Plated layer | ニッケル/Nickel |
| | 2C MLCC 下地電極/MLCC Electrode | 銅/Copper |
| ③ | MLCC 誘電体素子/MLCC Dielectric layer | チタン酸バリウム系/Barium titanate-based |
| ④ | MLCC 内部電極/MLCC Inner electrode | ニッケル/Nickel |
| ⑤ | インターポザ基板/Interposer | ガラスエポキシ/Glass Epoxy |
| ⑥ | 接続はんだ/Solder | 無鉛はんだ(すず・銀・銅系)/ Lead Free Solder(Tin-Silver-Copper series) |

J(E)MCZ0-1R077D

<ご参考> 当社ウェブサイトにて、各シリーズの最新の構造図を手いいただくことが可能です。 → [構造図/材料表](#)

<Reference> The latest structure diagrams of each series are available on our website. → [Structure diagram, Materials chart](#)